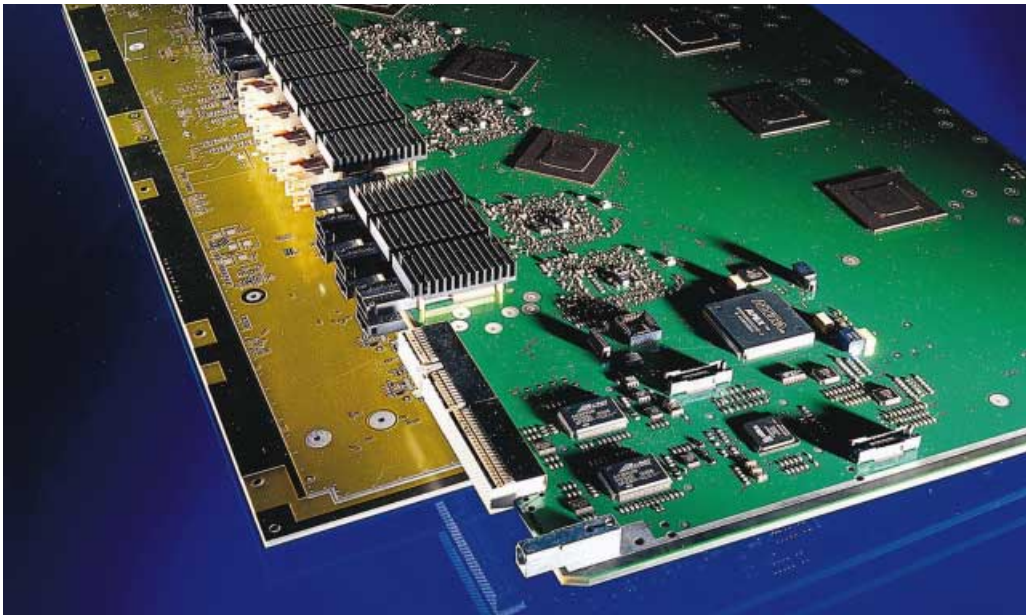


Kompetenzen finden sich: Hightech-Leiterplatten

(High Density Interconnection) HDI-Baugruppen



*Produkte neuester Generation und Technologien CX1000 und CCU ALCATEL Übertragungssysteme
500x310x3mm; 20 Lagen FR4; 6 Microvia-Bohrungen pro Seite; Buried-Vias; 1,2 GBit/s*

Ein Trend in der Elektronikindustrie ist die Steigerung der Leistung bei gleichzeitiger Miniaturisierung der Produkte. Als Antwort auf diese Herausforderung entstehen so genannte HDI-Baugruppen oder Leiterplatten mit folgenden Merkmalen:

- > sehr hohe Verbindungsdichte > 1000 Verbindungen/dm²
- > mittlere Kontaktdichte > 20 Pads/cm²
- > Einsatz von lasergebohrten Umsteigern, auch Microvias genannt (> Ø 80 µm); hier wird auch von (Sequentiel Build Up: semisequentielle Aufbautechnik) SBU-Leiterplatten gesprochen
- > bis 3 GBit/s bei Verwendung neuer Leiterplatten-Materialien

ALCATEL

ALCATEL und TZ CIS verfügen seit längerer Zeit über diese Technologien. Gemeinsam entstand das Design des Produktes CCU. Unterstützung im Design wurde auch für das Produkt CX1000 geleistet.

Dank unserer Kompetenz vergibt ALCATEL der TZ CIS als nächstes Projekt die Entwicklung der 10 GBit/s 64 Channel Endstage Matrix EM64.

TZ CIS
Steinbeis-Transferzentrum
Customer Innovative Solutions

Leiter | Ansprechpartner:
Dipl.-Ing. Gerhard Burg

Cx-Projektleiter:
Dipl.-Ing. Jean-Paul Schweitzer

Albert-Nestler-Straße 10
76131 Karlsruhe

Telefon [07 21] 6 27 15-0
Telefax [07 21] 6 27 15-19

E-Mail: info@tzcis.de
www.tzcis.de

